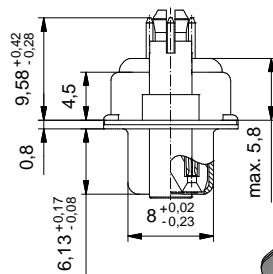
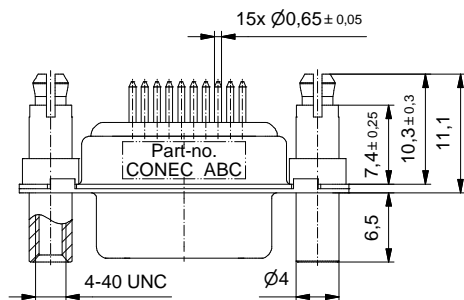
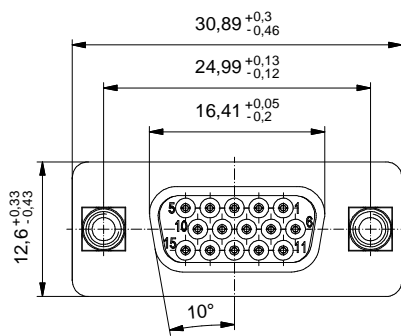
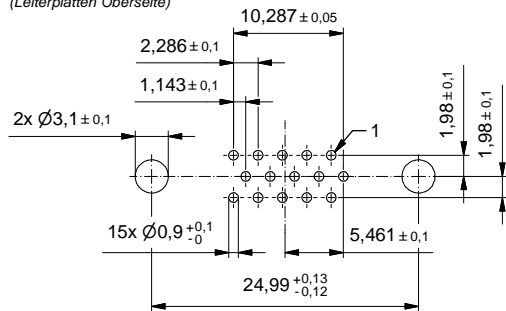


Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Capacitance value/ Kapazitätswert:
24-004923	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	370 pF ± 20 %
24-004922	2	20 µm hard gold over min. 50 µm nickel 20 µm Gold über min. 50 µm Nickel	
24-004921	1	30 µm hard gold over min. 50 µm nickel 30 µm Gold über min. 50 µm Nickel	
24-004933	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel	830 pF ± 20 %
24-004932	2	20 µm hard gold over min. 50 µm nickel 20 µm Gold über min. 50 µm Nickel	
24-004931	1	30 µm hard gold over min. 50 µm nickel 30 µm Gold über min. 50 µm Nickel	

**Technical specification/
Technische Daten:**

Working voltage/ Betriebsspannung:	100 VDC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	2,5 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 1 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV):	300 VDC
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 105 °C
Capacitance value/ Kapazitätswert:	see table/ siehe Tabelle
Mating cycles (see table)/ Steckzyklen (siehe Tabelle):	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

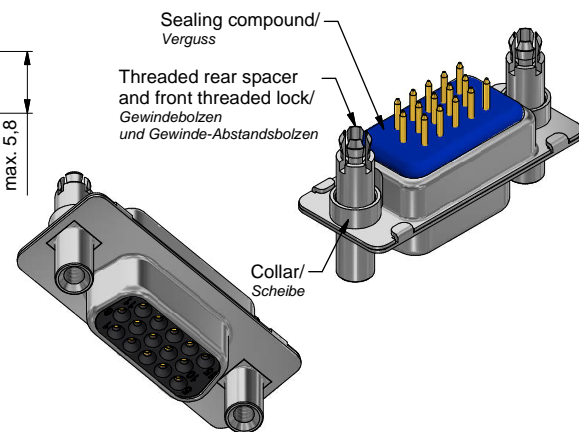


**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni Contact tails pretinned/ Kontaktspitzen verzinkt
Insulator/ Isolierkörper:	High temp. PA UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer and front threaded lock/ Gewindebolzen und Gewinde-Abstandsbolzen:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
Sealing compound/ Verguss:	PUR

**Installation specification/
Montagedaten:**

Solder parameter/ Lötparameter:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	100 °C for 30 sec./ 100 °C für 30 Sek.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	260 °C for 5 sec./ 260 °C für 5 Sek.
Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
PCB clip for hole diameter/ PCB Snap für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm



		dim. in mm		D-SUB HD C-Filter Female 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock D-SUB HD C-Filter Buchsenleiste 15pol. mit Gewindebolzen und Gewinde-Abstandsbolzen	
		Date/Datum	Name		
		drawn/ gez.	13.07.2022	Unkrüer	
		appd./ gepr.	14.07.2022	Lehmenkühler	
Index: a Original	scale/maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 24K1A2296		DIN-A3	
RoHS compliant/konform		CONEC®		1 / 1	